

DIELEC II PI

LIMPIADOR ELECTRÓNICO DE SECADO LENTO

Código I-29-15, Versión 1.1, Diciembre 16 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

DIELEC II PI Es un limpiador y desengrasante para limpiar equipos y componentes electrónicos. Trabaja sin dejar residuos o película grasosa, aunque de secado lento.

Especial para equipos electrónicos; terminales y conectores de pasta.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- No Inflamable ni conductivo ni corrosivo.
- Efectivo para todos los componentes y partes.
- Reduce el inventario de limpiadores.
- Aplíquese en equipos desmantelados.
- No afecta la capa de ozono.
- Rigidez dieléctrica de 18.000 voltios.

APLICACIONES.

Se utiliza como limpiador y desengrasante para componentes electrónicos y equipos donde no se presentan puntos calientes u otras fuentes de combustión. Retira grasa, aceite, suciedad superficial y partículas extrañas de controles de precisión, interruptores, motores, controles electrónicos, componentes, tarjetas de circuitos impresos, redes telefónicas y cabezas de grabación.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Sostenga el aerosol a 15 o 20 cms de la superficie a limpiar, luego rocíe el producto sobre ella. Después de limpiar, deje secar completamente antes de colocar nuevamente en servicio.

Consulte la etiqueta del aerosol para indicaciones adicionales y precauciones antes de usar.

Somos la **Química** en su **Industria**



DIELEC II PI

LIMPIADOR ELECTRÓNICO DE SECADO LENTO

Código I-29-15, Versión 1.1, Diciembre 16 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Líquido claro.

Color: Incoloro.

Olor: Solvente.

Gravedad específica: 1.60 – 1.70

Solubilidad en agua: Insoluble.

Viscosidad: No viscoso.

Ingrediente activo: Tetracloroetileno.

CAS N°: 127-18-4

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad química: No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Posibilidad de reacciones peligrosas: Metales alcalinos, Riesgo de explosión por presión en aerosol.

Condiciones que deben evitarse: Exposición a la luz. Exposición a humedad. Descomposición térmica: > 150 °C.

Materiales incompatibles: Evite el contacto con metales como aluminio en polvo, magnesio en polvo, potasio, sodio y zinc en polvo. Evite contacto intencionado con aminas. Evite el contacto con bases fuertes y oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: Las llamas abiertas y arcos de soldadura pueden causar degradación térmica generando cloruro de hidrógeno y pequeñas cantidades de fosgeno y cloro. En la presencia de Aluminio y cantidad excesiva de agua la descomposición procede rápidamente produciendo grandes cantidades de calor y HCL.

PRESENTACIONES.

Aerosol de 20 onzas.

DEMOSTRACIONES.



Somos la Química en su Industria

